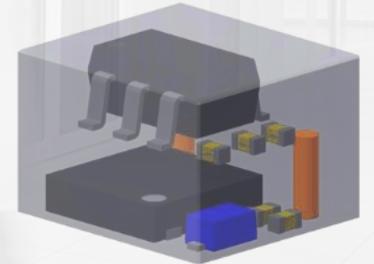
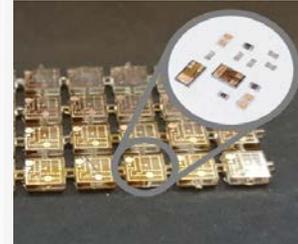
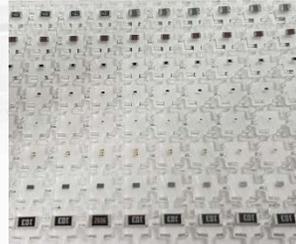
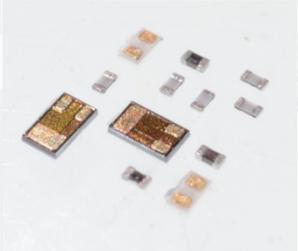
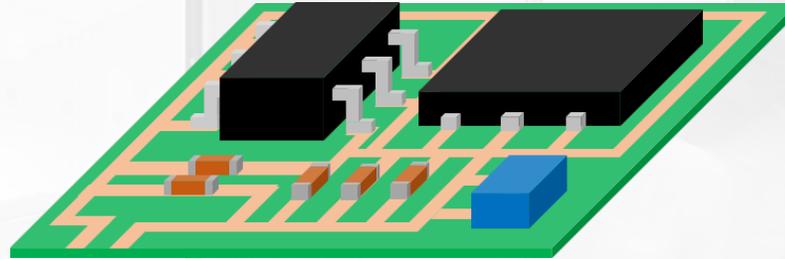
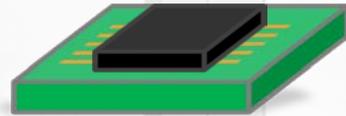
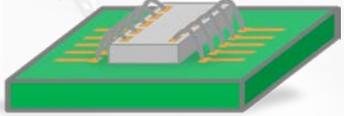


MICROPACK3D

- **Adaptives Elektronisches Packaging**
- Start-up der TU Dresden
- Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik (IAVT)
- EXIST gefördert

TECHNOLOGIE



MEHRWERT



ANWENDUNGSFELDER

- Sensorelektronik
- Test Packaging
- Hochfrequenz
- Leistungselektronik
- Miniaturisierung / 3D Elektronik

GESUCHTE KOOPERATIONSFORMEN

- Entwicklungsprojekte / Förderprojekte
- Machbarkeitsstudien / Test-Packages
- Prototypen / Kleinstserienfertigung / Engineering Samples
- Pilotanwender
- Innovative Produkte



Kontaktieren Sie uns gern:

**Technische Universität
Dresden – IAVT
Friedrich Hanzsch (+49 351
463 33007)
Helmholtzstraße 10
01069 Dresden
Deutschland
info@MicroPack3D.de
www.micropack3d.de**

Das Projekt **Kontaktierung eingebetteter Komponenten als Technologielösung**, kurz: KONEKT (FKZ: 03EFMSN148) wird im Rahmen des EXIST Programms durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.